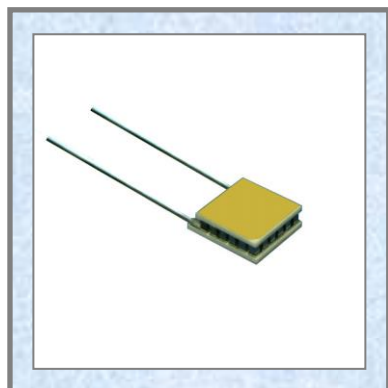


# THERMO MODULE DATA

型式 KSMH018

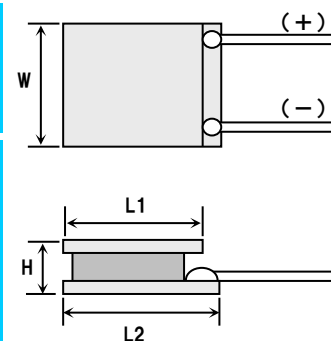
RoHS 2002/95/EC Compliant



Th	$\Delta T_{max}(^{\circ}C)$	$I_{max}(A)$	$V_{max}(v)$	$Q_{cmax}(w)$
27°C	75	2.0	2.2	2.5
70°C	93	2.0	2.7	2.8

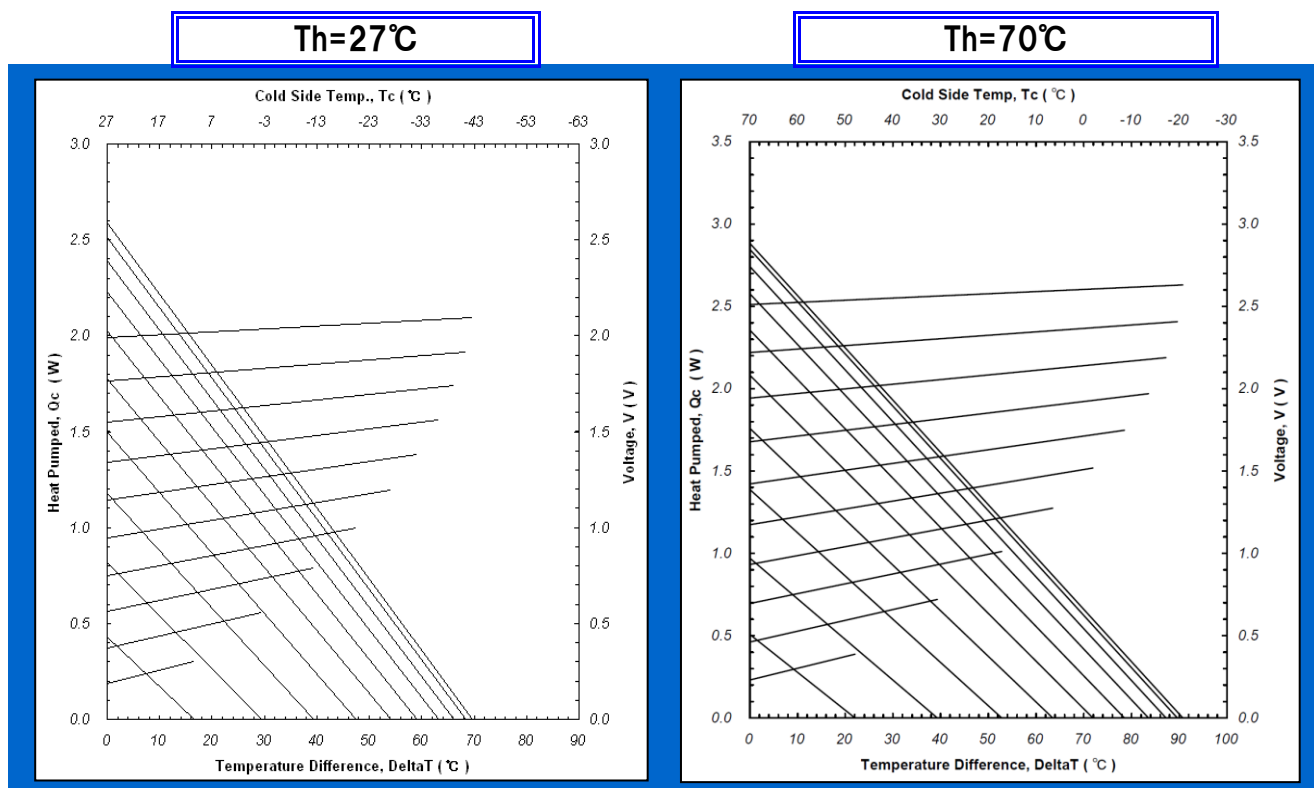
	W	L1	L2	H
寸法(mm)	6.0	6.2	7.2	1.65
公差(mm)	±0.2	±0.2	±0.2	±0.1
上下メタライズ	Cu-Ni-Au			
セラミック材質	アルミナ			
組立半田	SnSb (融点232°C)			



## オプション

組立半田	AuSn (融点280°C)
セラミック材質	窒化アルミ、またはアルミナと窒化アルミの組み合わせ
予備半田	InSn(融点117°C)、BiSn(融点138°C)、組立半田AuSnを選定時はSnAgCu(融点217°C)も対応可能

## 性能特性図



雰囲気	窒素
電流値	I = 0.2 - 2.0 A ( Step = 0.20 A )

株式会社KELK

- 本社・工場
- 営業部 素子営業Gr

www.kelk.co.jp

〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1 TEL 0463-22-8724 FAX 0463-22-3692  
 〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1 TEL 0463-23-3697 FAX 0463-22-8277  
 E-mail : JPE7MB\_homepage\_kelk@global.komatsu